

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒电话会议 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券、国金证券、中金公司、广发证券、华安证券、方正证券、华福证券、长江证券、西部证券、国盛证券、华创证券、银河证券、惠理基金、南土资产、易方达基金、融通基金、鸿道投资、复胜资产、汐泰投资、胤胜资产、同巨投资、聚鸣投资、近达投资
时间	2025年7月7日-7月16日
地点	公司会议室、线上会
公司接待人员姓名	董秘，财务负责人：王俊林 证券事务代表：王宁
投资者关系活动主要内容介绍	一、问答环节 1. 公司铜箔整体产能布局情况怎样？ 答：公司现有铜箔产品总产能为 8 万吨/年，对应的产品类别分别为 PCB 铜箔和锂电池铜箔。 2. 公司的铜箔产品结构如何？ 答：公司 PCB 铜箔主要分为 HTE 铜箔和高频高速铜箔，2024 年高频高速铜箔占 PCB 铜箔全年产量 25.33%，今年比重进一步提升。锂电池铜箔产品中 6um 及以下规格的铜箔占比超过 95%，中、高抗拉和超薄铜箔产品比重也在稳步提升。

	3. 公司收入确认方式是怎样的，铜价的波动影响大吗？ 答：公司采用“铜价+加工费”的定价模式，与长期良好合作关系及规模较大的战略客户采用“月均价模式”，公司会根据铜价和订单情况，调整产品价格，另外公司也开展套期保值业务用以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险。 4. 高频高速铜箔中 HVLP 铜箔有什么进展？ 答：HVLP 铜箔也就是极低轮廓铜箔，表面粗糙度极低，具备出色的信号传输性能、低损耗特性以及极高的稳定性，是极低损耗高频高速电路基板的专用核心材料，能在在 5G 通信和 AI 领域广泛应用。 公司始终坚持创新驱动发展，较早立项研发 HVLP 铜箔，攻克关键核心技术，打破海外技术封锁，有效替代进口产品。该产品的生产技术及产品质量均达到国际先进、国内领先水平。 目前该产品已成功进入多家头部 CCL 厂商供应链，订单饱满，公司具备 1-4 代 HVLP 铜箔生产能力，目前以 2 代产品出货为主。 5. HVLP 铜箔订单饱满，产能是否能跟上？ 答：公司前瞻性布局高端铜箔市场，拥有多条 HVLP 铜箔完整产线，近期新购置多台表面处理机以扩充 HVLP 铜箔生产，满足未来增长需求。 6. HVLP 铜箔生产难点在哪？ 答：主要体现在设备精密程度要求高，订货周期长、生产工艺复杂，精度要求高、客户认证门槛高，周期长。 7. 铜箔进口情况如何？ 答：HVLP 铜箔市场主要被日本等海外企业占据主导。根据海关统计 2023 年我国进口电子铜箔 7.9 万吨，2024 年进口 7.6 万吨，主要是高频高速铜箔，国内这方面做的比较少。公司近年来高频高速铜箔出货增速加快，加速国产替代进程。
附件清单	无
日期	2025 年 7 月 17 日